附件5

2020年 公司芯片流片情况明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目（MPW/工程批） | 产品型号 | 流片厂商 | 发票信息 |
| 发票号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额（含税，单位：元） | 开票日期 | 开票方名称 |
| 美元 | 汇率 | 人民币 |
| MPW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 工程批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.本表由申请多项目晶圆（MPW）流片补助和申请首次完成全掩膜（Full Mask）工程流片补助的集成电路设计企业填写；

2.MPW/工程批流片费用支出时间为2020年1月1日-2020年12月31日。